

## 武汉精测电子集团股份有限公司

## 关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2019年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、苏州精瀚光电有限公司（以下简称“苏州精瀚”）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）、宏瀚光电有限公司（以下简称“宏瀚光电”）生产经营目标及发展需要，董事会同意公司及子公司2019年度以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，拟向银行申请最高额不超过23.05亿元人民币及2.93亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体情况预计如下：

公司名称	银行名称	申请最高授信额度
精测电子	招商银行	6亿元人民币
	民生银行	4亿元人民币
	浙商银行	2亿元人民币
	交通银行	1.9亿元人民币
	兴业银行	4亿元人民币
武汉精立	交通银行	1,000万元人民币
苏州精瀚	中信银行	8,000万元人民币
	建设银行	5,000万元人民币

	宁波银行	5,000 万元人民币
	农业银行	5,000 万元人民币
昆山精讯	中信银行	8,000 万元人民币
	宁波银行	5,000 万元人民币
	建设银行	8,000 万元人民币
	农业银行	5,000 万元人民币
安徽荣创	中国银行	1,500 万元人民币
宏濂光电	彰化银行	1.83 亿元新台币
	第一银行	1.1 亿元新台币

上述额度共计 23.05 亿元人民币及 2.93 亿元新台币，有效期自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施。

#### 备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日